

信頼性試験結果

Reliability Test

XC9110Eシリーズ (DC/DCコンバータ)

XC9110E Series (DC/DC Converters)

パッケージ : SOT-25
Package

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VDD=(Specified Output Voltage)-0.5V Lx=5V	1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C	1000	0/22
3	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VDD=Lx=10.8V	1000	0/22
4	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-55°C~125°C 各30分 30min Each	100CYC.	0/22
5	プレッシャークッカーバイアス HAST	125°C85%RH VDD=Lx=10.8V 2×10 ⁵ Pa	100	0/22
6	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C170秒/260°C50秒)2times→ 85°C85%RH24h→reflow(150~200°C170秒/260°C50秒)1times IPC/JEDEC J-STD-020D 準拠		0/110
7	静電耐圧 Electric Static Discharge.	R=0Ω C=200pF ±200V以上 各端子3回 ±200V over 3times Each		0/20
		R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 各端子3回 ±1kV over 3times Each		
8	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回 ±100V over 3times Each		0/5
		50mA以上 50mA over		

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n	
1	端子引っ張り Terminal Strength	1N 10秒 1N 10s	0/5	パッケージ代表データ Performed with samples that represent the applicable PKG type.
2	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒(プロファイル昇温法) 10s (Temperature profile method)	0/11	